NANSHIKYAKYUBOORUNO SEIZOHOHO

Publication number: JP51100833 (A)

Publication date: 1976-09-06
Inventor(s): NAKAMURA KENICHIRO; SATO SHIGEO

Applicant(s): SHOWA RUBBER
Classification:

- international:

B29D31/00; A63B45/00; B29B15/00; B29C51/00; B29C69/00; B29D31/00; A63B45/00; B29B15/00; B29C51/00; B29C69/00;

(IPC1-7): A63B45/00

- European:

Application number: JP19750024827 19750228 Priority number(s): JP19750024827 19750228

Abstract not available for JP 51100833 (A)

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

Also published as:

P1059165 (C)

(1)特許出願公告

特許 公 報 昭53-21709

60 Int.Cl.2 B 29 H 7/04 A 63 B 45/00 微别記号 经日本分類 25(7) B 4 120 G 518.2

7179 - 376692-25 発明の数 1

(全5頁)

1

の軟式野球ボールの製造方法

顧 昭50-24827 ②特

顧 昭50(1975)2月28日 @H 公 開 昭 5 1 - 1 0 0 8 3 3

636351(1976)9月6日

73発 明 者 中村健一郎

佐倉市臼井田552の45 佐藤繁雄

百 東京都墨田区文花3の21の9

願 人 昭和ゴム株式会社 の出 東京都中央区京橋2の6

配代 理 人 弁理士 谷山輝雄 外2名

の特許精求の範囲

1 所定の厚さを有する二枚の未知硫ゴム平板を、 その内側面の曲率半径が接合面に対して中央部に おいて40~50 R、圧着切断周縁部において 10~20Rの曲率を有する上下一対の第一次成 型金型の曲面に夫々吸引密着せしめ、次いでその 20 型よりやや大きい上下一対の第三次成形金型、第 上下吸着ゴム板相互間に膨脹剤を投入した後該上 下金型を圧着し、金型分割面にてゴム片を圧着接 合し、やや偏平な中空内層素体を一次成型し、次 いで、この素体を内側面が半球面をなし、かつ、 その半球面積が第一次成型金型の曲面積と等しい 25 への変化率を極力小さくおさえ、変形時の厚さの変 冷却された上下一対の第二次成形金型内にその接 合面を直立させて装てんし、徐々に該一対の金型 の圧着力により前記案体を球形に整形し、次いで 前記第二次成形金型の半球曲面積よりもやや大の 半球曲面積を有する半球状の上金型と第二次成形 30 性を増加させてあるのでゴム平板の半球化に際し、 金型の半球曲面積と同一面積及び形状を有する下 金型とからなる上下一対の第三次成型金型の下金 形内に前記中空体を装てんし、 該球体の上部に加 温し、かつ所定の厚さを有する未加硫ゴム平板を のせ上金型の半球面を吸引しながら該上下金型を 35 である。 圧満し中空球体の外側に半球状に接着させ、次い で上金型の半球面に、その球体を吸引保持せしめ

たがら F下金型を分割し、次いで、上金型に吸引 保持される球体を第三次成形金型の上金型と同一 形状及び面積を有する第四次成形用下金型の半球 面上にのせてある加温した所定厚さの未加硫ゴム 5 平板上にのせてそれら上下金型を圧着し、中空球 体の外側に半球状に接合させ内外二層からなる中 空球体を成形し、しかる後別の内側に意匠をつけ た半球部を有する上下一対の加硫成形用金型にて 加硫成形することを特徴とする軟式野球ポールの 10 製造方法。

庁内整理番号 → 3公告 昭和53年(1978) 7 月 4 日

2

発明の詳細な説明

本祭明は献式野球ポールの製造方法に関するも ので、さらに詳しくはその内側面の曲率半径が接 合面に対して中央部において40~50R、圧着 15 切断間縁部において10~20 Rの曲率を有する F下一対の第一次成形金型、冷却され内側が半球 よりたり内部の表面積を第一次成形金型の球面と 同一にする上下一対の第二次成形会型、内側が半 球よりなり上金型のみ半球の口径が第二次成形金 三次成形金型の上金型と同一形状の下金型からな る無四次成形金型および加硫成形金型を用い、あ らかじめ特別な方法で未加硫 ゴム半球体を用意せ ず、平板を用い、第一次成形金型による球面状化 化を防ぎ、第二次成形金型にて偏平な中空素体を 東円球体に整形し、さらに外側のゴム層は同様ゴ ム平板を充分に加熱軟化せしめておき、一方内側 の中空球体冷却された金型内にて充分冷却され剛 買さの変化は全く生ぜず内外層共に厚さが均一で、 1.かも会測による接合のため、均一にして完全な 接合面を有することを特長とし、省力化され生産 性の高い軟式野球ポールの製造方法に関するもの

従来より軟式野球ボールの製造方法として所定 の厚さを有する二枚の亜鈴形(ひようたん形)の

未加硫ゴム片を手作業によりその螺面同志を接合 し内側素体を成形し、次いでその外側にやや大き い同一形状の未加硫ゴム片を内側素体の表面に接 合させながらその端面同志を接合し、内外二層構 造の中空体を成形し加硫成形する方法や、内側素 5 体の成形を内側が球面よりなる上下一対の金型内 に未加硫ゴム片を吸引密着せしめ、その上下金型 を圧着してゴム片を接合し、次いでこの内側素体 の外側に二枚の距鈴形の未加硫ゴム平板を手作業 中空体を成形し、加硫成形する方法、またこの方 法を改善する方法として適宜方法により予め半球 状に成形された未加硫ゴム片を内側が半球よりな る上下金型内に装てんし、その半球面に吸引密着 中空球体を成形し、該中空球体の外面に外側ゴム 層を接合させるにあたり、前記成形金型より内側 の半球の口径がやや大きい上下金型に半球状未知 硫コム片を中空球体に対し凸状に装てんし中空球 外側に外層ゴムを接合せしめ内外二層構造の中空 球体を成形し、加硫成形する方法などがある。

上記方法において手作業により亜鈴形ゴム片を 接合する方法は得られる中空体が立方体に近く、 厚さの変動の原因となり好ましくない。またゴム 片の接合作業も高度の熟練と経験が必要で生産性 も当然低くなる。また内側の中空体のみを金型で 成形し外側を手作業にて接合する方法も一部改善 方法もあらかじめ特別な方法で半球状未加硫ゴム 片を用意せねばならず、特別な装置、工数を必要 とする。また外側ゴム層を接合させる工程を真空 室内で行う必要があり実施上種々の困難をともな うるのであつた。

本発明はかかる欠点を解消せんとするもので、 その目的とするところは従来法により得られた軟 式野球ボールが有するゴム厚の差、あるいは接合 部のずれ等による打球時のボールのぶれ、象裂、 高い軟式野球ボールの製造方法を提供せんとする もので、その内側面の曲率半径が接合面に対して 中央部において40~50R、圧着切断周縁部に おいて10~20Rの他率を有する上下一対の第

一次成形金型と内側が半球よりなり球面の表面積 を第一次成形金型の全球面の面積と同一にする冷 却された上下一対の第二次成形金型と内側が半球 よりなり上金型のみ半球の口径が第二次成形金型 よりもやや大きい上下一対の第三次成形金型と第 三次成形金型の上金型と同一形状を有する下金型 からなる第四次成形金型および加能成形金型を用 い、従来のようなあらかじめ特別な方法による未 加硫ゴム半球体を用意せず、未加硫ゴムの平板を により内側素体の上に接合せしめ内外二層構造の 10 用いて第一次成形金型による球面状化への変化率 を極力小さくおさえ、変形時の厚さの変化を防ぎ 第二次成形金型にて偏平な中空体を真円球体に整 形し、さらに外側のゴム層は同様ゴム平板を充分 に加温軟化せしめておき、一方内側用中空球体は せしめた後、上下金型を圧着してゴム片を接合し、15 冷却された金型内にて次分冷却され剛性を増加さ せてあるのでゴム平板の半球化に際し、厚さの変 化は全く生ぜず、内外層共に厚さが均一で、しか も金型による接合のため均一、かつ完全な接合面 を有し同時に球体成形に際しゴム片接合上の高度 体をはさみ真空下において圧着せしめ中空球体の 20 の熟練や経験を必要とせず省力化、生産性向上等 の効果が得られる。

以下、本発明を図面に示した実施例によって説 明する。第1回における1,14内側が曲率半径 44 Rと11 Rからなる曲面凹部2,2/を形成し 加硫成形時の球体への変化に際し変化率が大きく、25 た上下一対の金型で、この一対の金型1,11で第 一次成形金型を構成している金型1,1/の球面の 周線には圧落切断線3,3を設け、この圧着切断 縁を接して上下金型1、1/は分割又は組合される。 又、上下金型1,10凹部には所定の間隔にて されたに過ぎず、内外層共に成形金型を使用する 30 複数個の吸引孔4 ,4%設け吸引孔は真空ポンプ (図示されず)に連結されている。第4回に示す 5,544内側に半球面6,66を形成した上下の金 型で、との上下一対の金型により第二次成形会型 を構成している。第6図に示す7は内径が金型5% 35 の内径よりもやや大きい径を有する半球面 8'を形 成し、該半球部の口縁には圧着切断縁 9/を設け又、 半球面に所定の間隔にて複数個の吸引用、1 8 を設 け、との吸引孔に真空ポンプ(図示せず)に連結 された上金型で、7は前記金型5の内径と同径同 破損等の惧れがなく、かつ省力化され、生産性の 40 形状の半球面 8 および圧着切断縁 9 を設けた下金 型で両金型 7 と 70 圧着切断線を接して分割 Vは 組合されるようになつている。第11図に示す 14及び14は内側面に意匠を刻印した半球部 15及び15を形成した上下一対の金型で、これ

ら一対の金型により加硫成形金型を構成し、これ ら金型の口縁に接して組合され又は分割される。

次に上記各成形会型による中空球体の成形につ いて述べると、先ず第一次成形金型1,1/の凹部 に設けた吸引孔4,4′に吸引作用を生ぜしめなが 5 ら上下金型1,10凹部2,20夫々に加温され た所定の厚さを有する夫々の未加硫ゴム平板16 を装着する。装着されたゴム平板は直ちに 4 4 R と11Rの曲面を有する凹部に吸引密着され、曲 面外のコム片は第1回に示すように圧着切断線3,10 形金型を分割し、取出せば軟式野球ボールが得ら 3'の外側に折り曲げる。次いで下金型のゴム板上 に膨脹剤17を投入し、しかる後、上下金型1, 1/を圧着させると第2図に示すように圧着切断縁 3,3/によってゴム片は圧満、接合されると同時 に余分な周辺部は切断され切り離される。次に吸 15 形金型を使用し、平板より球面状化への変化率を 引を停止し上下金型を分割、引き離すと第3回に 示すように余分な周辺部が切り離された偏平な中 空体18が得られる。かくて、との中空体18を 第一次成形会型より取り出し、第4図に示す冷却 された第二次成形金型5,5個に接合面を直立さ20破損等の惧れのない高度の品質を有するもので、 せて装てんし、しかる後この上下金型5,5を圧 着させ中空体18が冷却するまで保持すると第5 図に示すように偏平な中空体は半球面6,6%にな じみ、真円中空球体19に整形される。次いで、 F下金型5,5%分割、引き難し中空球体を第6 25 図面の簡単な説明 図に示す第三次成形会型の下金型7に葬てんし球 体の上部に加温された未加硫ゴム平板 16'をのせ、 上部会型での半球部を吸引孔10により値かに吸 引しながら上下金型を圧着させると第7図に示す 如く未加礎コム平板16位中空球体の上半部をつ30第5図は同金型による成形工程の断面図、第6図 つみ込みながら内部の中空球体面に接合され同時 に全分た 周辺部のゴム辺縁は圧着切断線 9 , 9'kc よつて切断され切り離される。次いで、上金型7/ の吸引力を高めて下金型を分割、引き離すと上半 部が二層構造となった中空球体20が上金型7/に35 断面図、第11図は加硫成形金型内に中空球体を 保持された状態で得られる。かくて、得られた中 空球体をト金型に保持したまま、第四次成形下金 型11上にのせられ、かつ加温された所定の厚さ を有する朱加硫ゴム平板16/上にのせ、しかる後 上下金型を圧着させると第9回に示す如く、未加 40 3/.....圧着切断縁、4,4/.....吸引孔、5,5/... 硫ゴム平板 1 6/は中空球体の表面をつつみながら 内部の中空球体面に接合され、すでに一部二層に 接合されている中空球体20の切断面と接合され、 同時に余分な周辺部のゴム片は圧着切断線13,

9/によって切断され切り離される。次いで吸引を 停止し、上下金型を分割、引き離すと第10回に 示すように余分な周辺が切り離された二層構造の 中空球体21が得られる。かくて得られた二層構 造の中空球体を金型より取出し、第11回に示す 如く加硫成形金型14,14中に装てんし、加熱、 加圧すると球体内部の膨脹剤がガス化し内圧が高 くなり球体は加硫金型の球面に押しつけられなが ら加硫成形される。かくて所定時間経過後加硫成

以上本発明の方法により製造される軟式野球ボ ールは 上述の如く未加硫ゴム平板より二層構造の 中空球体を成形するに際し第一次から第四次の成 極小さくおさまているのでゴム厚の変化が少く、 又接合も圧着切断線を有する成形金型を油圧プレ ス等の機械力によつて圧滞せしめるため、常に均 一な接合部となり、従つて打球時のふれ、無空、 従来の手作業により成形した軟式野球ポールの品 質面の欠点を解消するもので同時に従来方法の如 き高度の熟練と経験を必要とせず、省力化、生産 性の向上等製造工程上にも積々の効果が得られる。

図面はいずれも本発明の実施例を示すもので、 第1回は第一次成形会型の断面図、第2回は同会 型による成形工程の断面図、第3図は得られる中 空体の断面図、第4図は第二次成形金型の断面図、 は第三次成形金型の断面図、第7図は同金型によ る成形工程の断面図、第8図は第四次成形金型の 断面図、第9図は同金型による成形工程の断面図、 第10図は得られる二層構造の未加硫中空球体の 装てんした状態を示す断面図、第12図は加硫成 形終了時の状態を示す断面図である。

1 , 1/······第一次成形上下金型、 2 , 2/······曲 率半年45Rと11Rの曲面から成る凹部、3, …第二次成形上下金型、6,6/……半球部、7, 7 第三次成形上下金型、8 下金型半球部、 8'····· 上金型半球部、9 , 9'······ 圧着切断線、 10 ……吸引孔、11 ……第四次成形下金型、

7

9

12……下金型半球部、13……下金型圧着切断 二層中空球体、22……軟式野球ポール。 緑14,14……加味成形上下金型、15,15′

……球面部、16,16/……未加硫ゴム平板、





